

デジタル社会に貢献する

 **メック株式会社**

東証プライム市場 4971

2026年3月28日（土）



株主様向け会社説明会 2026年3月28日

本日の内容

- メック株式会社について
- 2025年12月期業績について
- 2026年12月期業績予想について
- 中期経営計画Phase2について

本日の内容

- メック株式会社について
- 2025年12月期業績について
- 2026年12月期業績予想について
- 中期経営計画Phase2について

会社概要

(2025年12月31日現在)

メック株式会社
MEC COMPANY LTD.

Machinery
Electronics
Chemistry

「機械」「電子」「化学」を
融合させた総合技術で社会に挑む

設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
事業内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造 販売及び機械装置、各種資材の販売
代表者	代表取締役社長 前田 和夫
資本金	5億9,414万2,400円
連結売上高	209億47百万円（2025年12月期）
上場市場	東証プライム市場（4971,化学）
従業員数	連結508名（単体292名）
拠点	日 本：兵庫県（本社/研究所/工場） 新潟県（工場）、東京都（営業所） 子会社：台湾,中国（蘇州/珠海）,タイ, ベルギー,インド（メックヨーロッパ 子会社）

株主構成（所有株式数）

	2024.6	%	2024.12	%	2025.6	%	2025.12	%
個人	4,494,753	22.4	5,449,991	27.2	5,168,933	25.8	5,162,196	26.4
金融機関	7,222,629	36.0	7,001,229	34.9	6,874,326	34.2	4,566,326	23.3
国内法人	1,594,803	7.9	1,589,729	7.9	1,637,330	8.2	1,615,406	8.3
外国人	5,050,026	25.2	4,530,395	22.6	4,400,381	21.9	5,296,168	27.1
証券会社	526,970	2.6	317,837	1.6	470,511	2.3	1,748,987	8.9

※%は小数点第2位を四捨五入しています

※自己名義株式は含みません

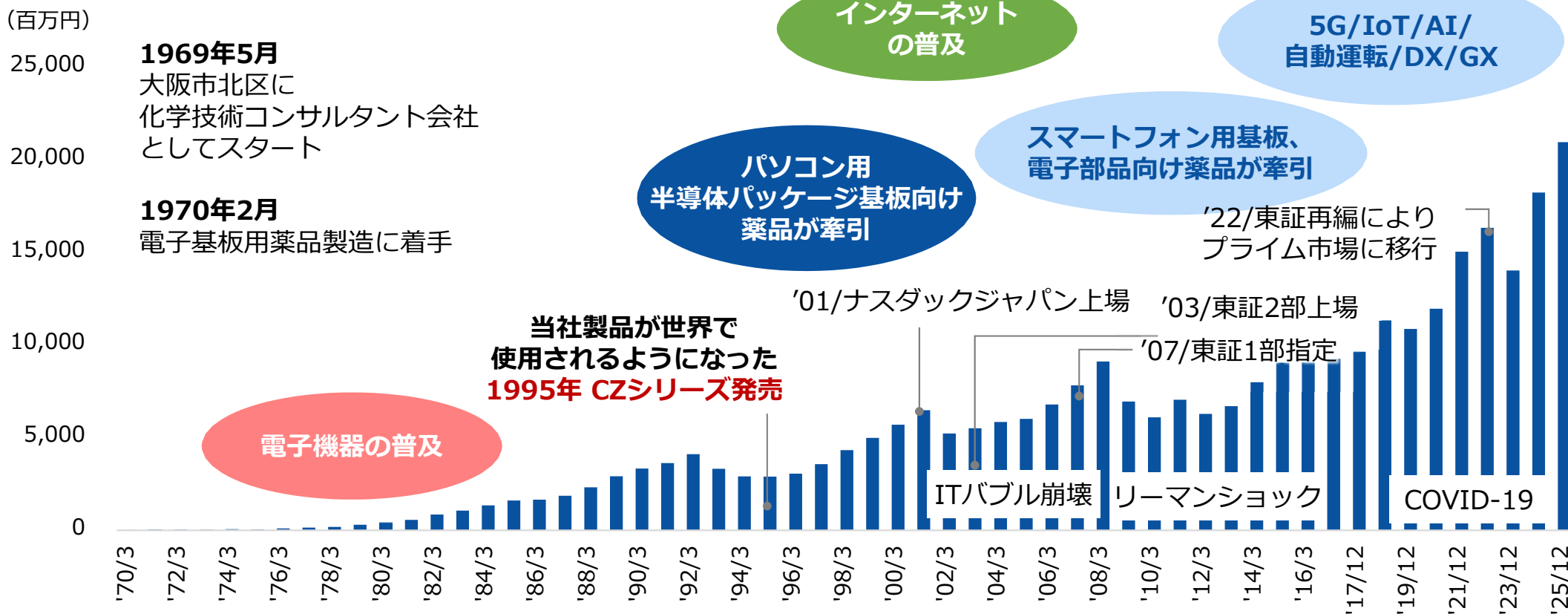
成長の軌跡

電子基板の用途が拡大するなか、市場のニーズをとらまえユニークな製品とサービスを提供しつづけ成長しています。

主に個人用端末で電子基板を使用

電子基板の用途が
社会インフラに拡大

売上高の推移



※2017年12月期（第49期）は、決算期変更により2017/4/1～12/31までの9カ月
 なお、連結対象期間については、当社は9カ月間（2017/4/1～12/31）、連結子会社は12カ月間（2017/1/1～12/31）

理念体系図

社是 (Company motto)
仕事を楽しむ

経営理念
Mission

経営理念 : わたしたちは「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、自由に着想し、グローバルな事業活動を通して界面価値創造を実現することで豊かで潤いのある社会と環境づくりに貢献します

Mission : 界面から、世界を変える

展望 / 目標
Vision / Goal

Vision : 界面の創出と接合で世界一になる

Goal : ありたい姿の実現

- ・ 真のグローバルカンパニーになる
- ・ 研究開発型企业であり続ける
- ・ 独創のAI企業としての顔を持つ

基本的な価値観
Value

- 社訓** :
1. 失敗を恐れず常に新しい目標に挑戦しよう
 1. 飽くなき好奇心で工夫改善を重ねよう
 1. 協調と感謝の気持ちで力を合わせ仕事を進めよう
 1. 安全と健康に気を配り楽しい職場を作ろう
 1. 広く社会に役立つことを心掛けよう

創造と変革 : 「つくる」を変える、「うる」を変える

人の“わ”を重んじ、唯一無二の価値を育む

社外への人の輪と、社内への人の和。価値を育むのは人である

コア技術

「密着向上」「配線形成」「選択エッチング」の技術で界面価値創造を実現します。

表面を粗化し、機械的に密着性を向上



表面を粗化せず、化学的に密着性を向上



配線を形成する



選択エッチング

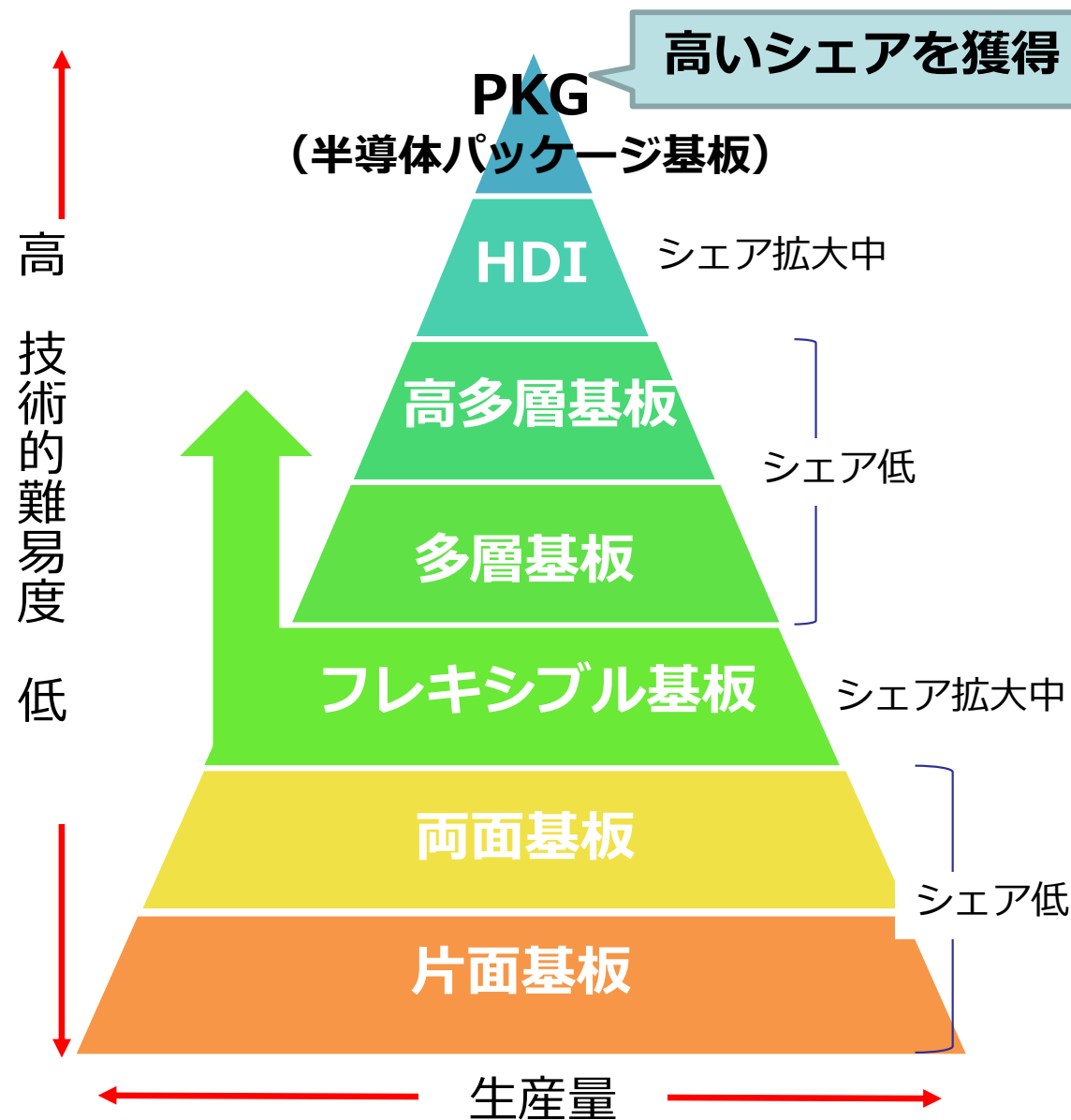
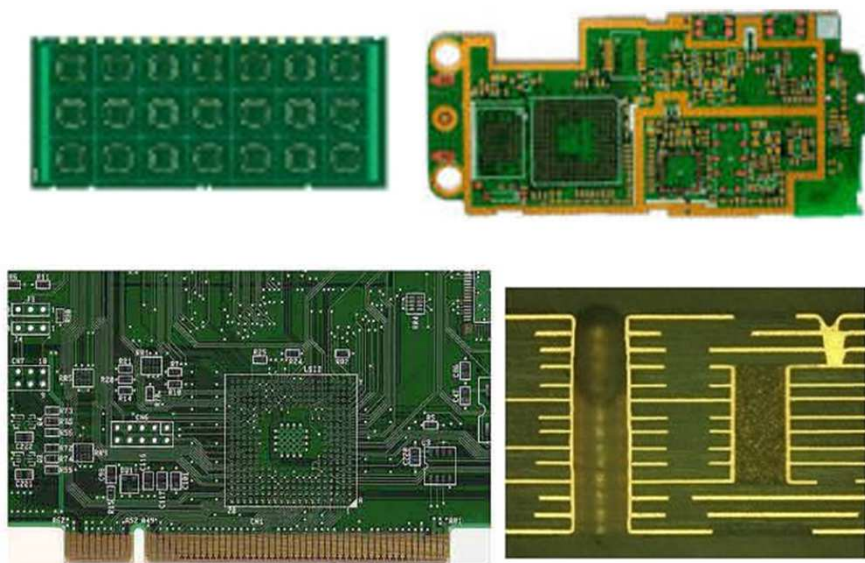


コア技術は金属を溶かす (エッチング)

当社の強み

当社は、私たちの暮らしに欠かせない電子基板製造工程で使用する薬品・機械を開発し皆様にお届けしています。

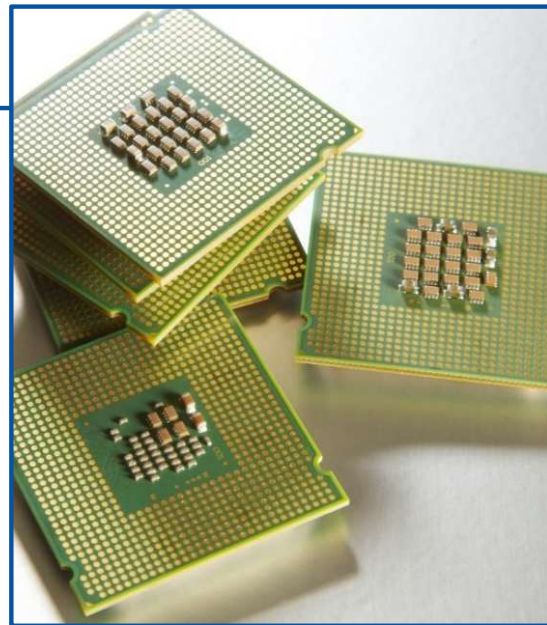
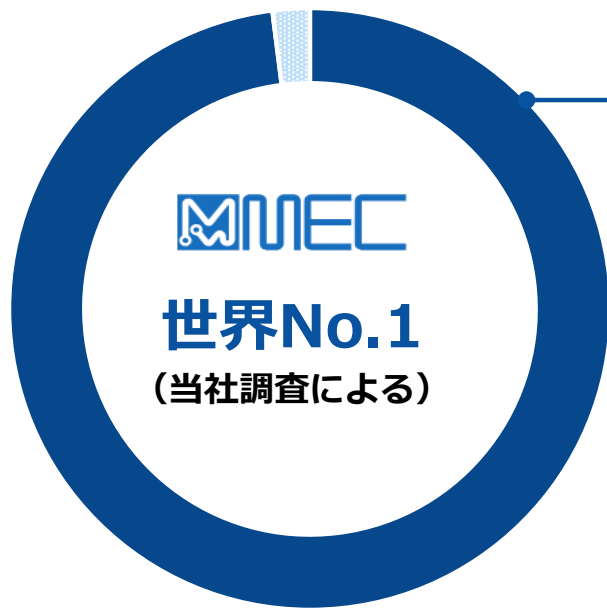
電子基板は、家電、通信機器、医療機器から飛行機や自動車産業機器まであらゆる分野で使用されています。



独自の技術力により世界独占的シェアを確立

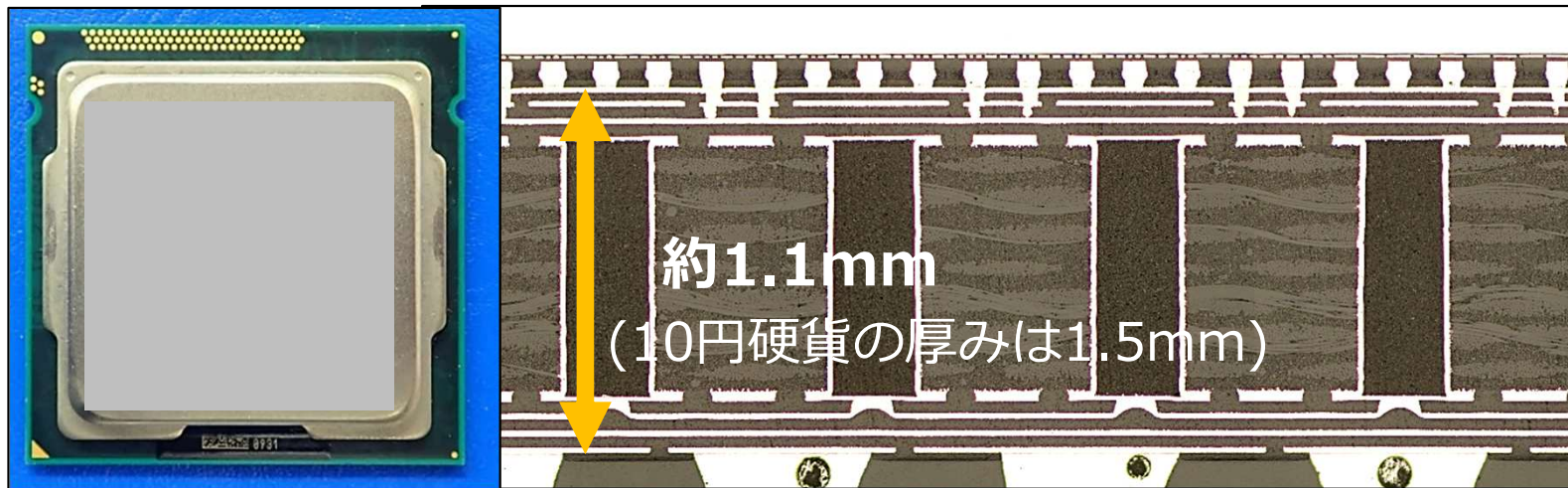
銅と樹脂の密着性を高める超粗化剤で、半導体パッケージ基板において世界市場における独占的シェアを確立。世界中の電子基板・部品メーカーなど、300社以上の顧客から評価・支持されています。

層間密着向上プロセスにおける世界的シェア（CZシリーズ）



- ・ 高い密着性と信頼性が認められ先行してシェアを確保
- ・ 30年以上の使用実績があり、CZ起因のエラーはゼロ
- ・ 顧客ニーズや市場状況を把握し継続的な製品改良を実施

半導体パッケージ基板 (PKG)



(イメージ)



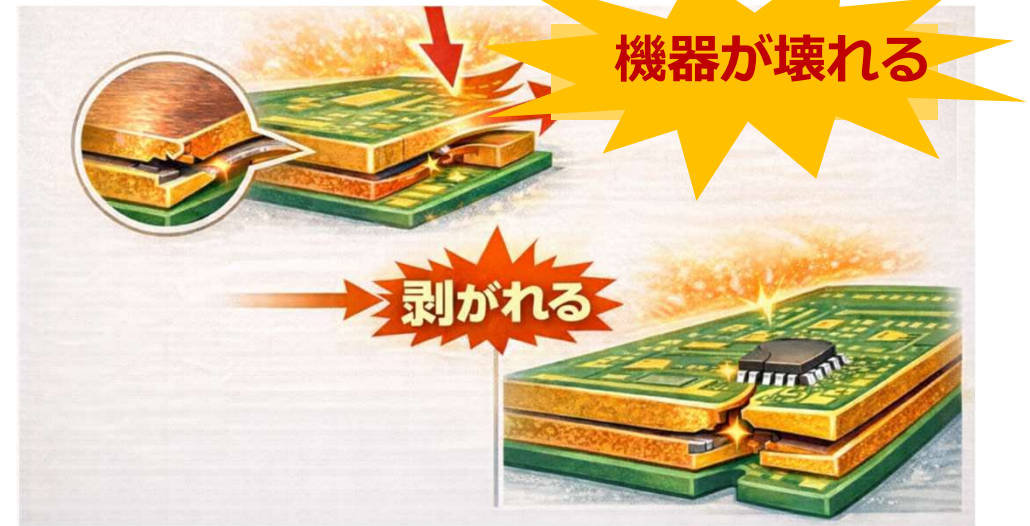
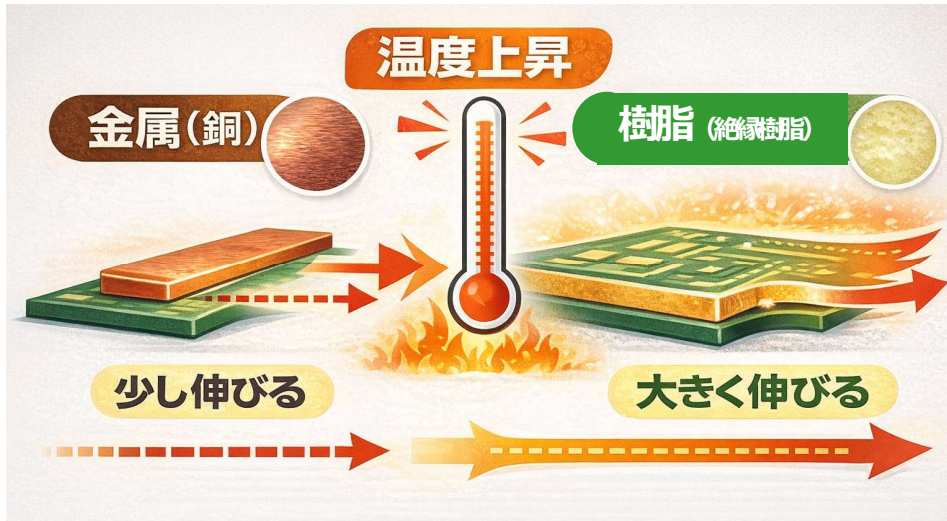
1mm = 1,000μm、1mm = 1,000,000nm

- 「PKG」は、半導体を載せメイン基板（マザーボード）との電気接続や情報伝達、半導体の外部環境からの保護等の役割を担う
- 上断面画像の白い部分は銅、暗い部分が絶縁樹脂。当社「CZシリーズ」は主に、層になっている銅の部分で使用されている

CZ使用量 = 個数 × 面積 × 層数

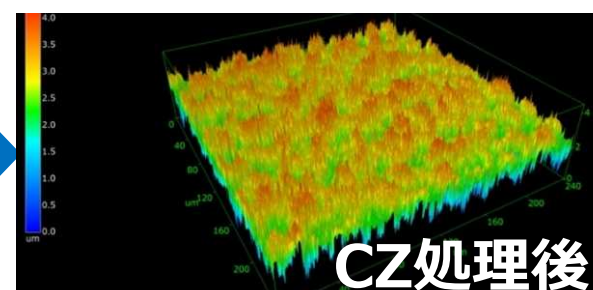
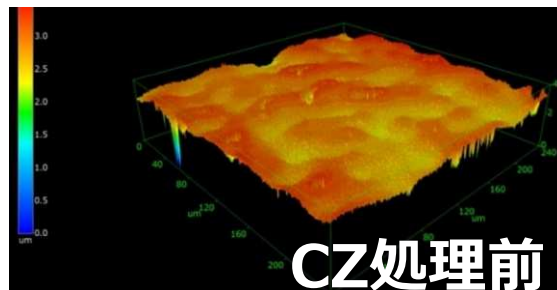
CZシリーズの役割

銅（配線）と樹脂の層の剥がれが電子基板の不良につながる



CZ処理で銅表面を微細な凹凸形状にし
銅と樹脂との密着性を大幅に向上するため剥がれさせない！！

電子基板の信頼性が上がる



製品の流れ



決定された開発テーマ、仕様に基づき、
結果が得られるまで徹底的に実験



研究開発から**配合表**

混ぜる



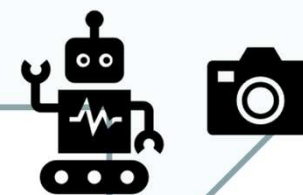
荷姿



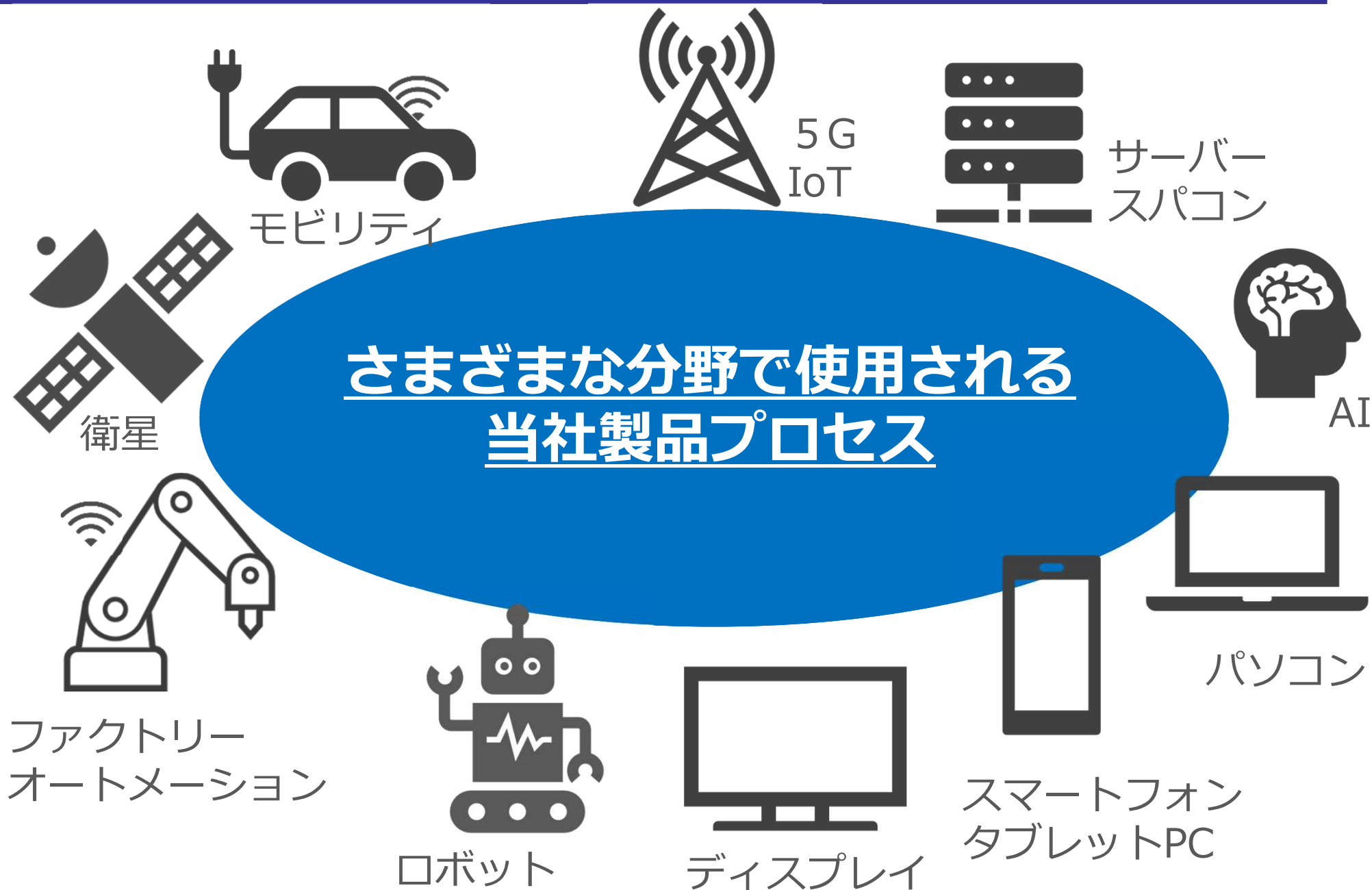
お客様：
基板メーカー
部品メーカー

研究開発から出てきた
配合表をもとに薬品を製造

当社工場で製品を生産



活躍できる分野



本日の内容

- メック株式会社について
- **2025年12月期業績について**
- 2026年12月期業績予想について
- 中期経営計画Phase2について

2025年12月期 総括

事業環境

当社が関係する市場は概ね堅調。データセンターにおいては、特に生成AI関連が市場の成長をけん引。パソコンやスマートフォンの出荷台数は前期比増加。

決算概況

前期比 増収増益 売上高、営業利益ともに過去最高を更新。

主要製品概況

- CZ : 前期比+19.8%。
主に生成AI関連やパソコンやスマートフォン等の需要により増加。
- V-Bond : 前期比 +1.1%。
車載基板向けや衛星関連基板向けの多層基板で健闘。
- EXE : 前期比 +4.9%。
ディスプレイ向け需要により微増。
- SF : 前期比▲30.5%
関連する電子機器の生産動向を受け減少。

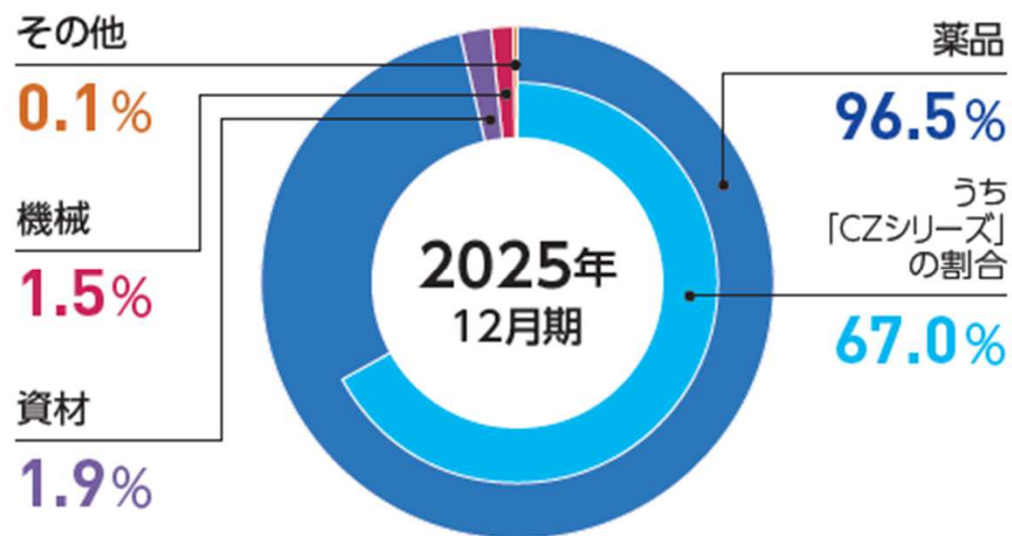
2025年12月期 業績概要

項目	FY2024 (実績)	FY2025		
		(実績)	前期比	
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(%)
売上高	18,234	20,947	2,713	14.9
営業利益	4,562	5,748	1,185	26.0
営業利益率	25.0%	27.4%	2.4pt	-
経常利益	4,682	6,051	1,368	29.2
当期純利益 ※	2,291	5,028	2,736	119.4
1株当たり当期利益 (円)	122.39	272.14	-	-

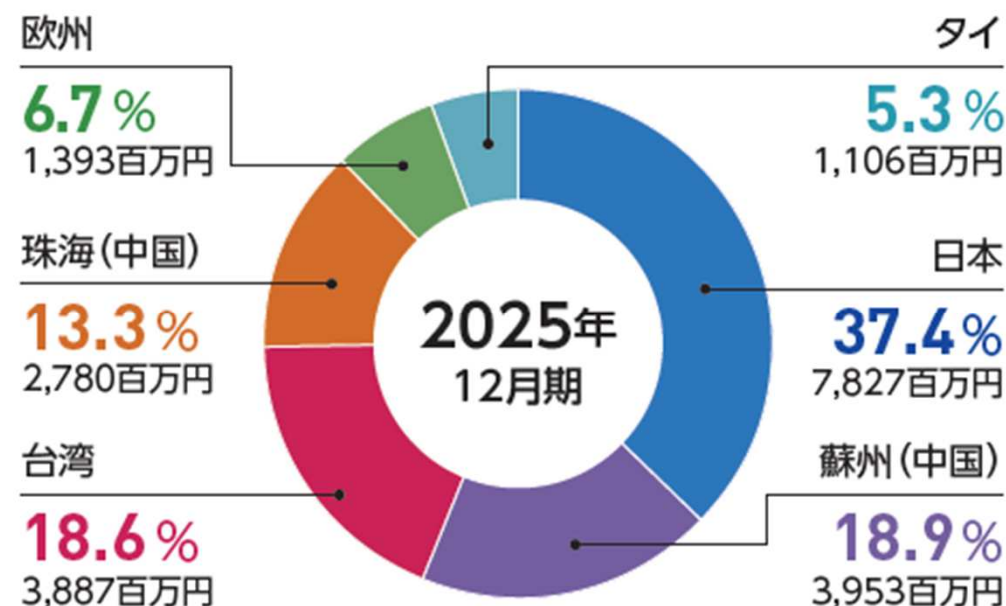
※FY2024：グループ再編に伴う日中両国の税金計上による法人税等の増加により利益を押し下げ
 FY2025：特別利益に経済産業省による「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」計上
 税額控除の獲得等により利益を押し上げ

売上構成

売上高に占める品目別割合



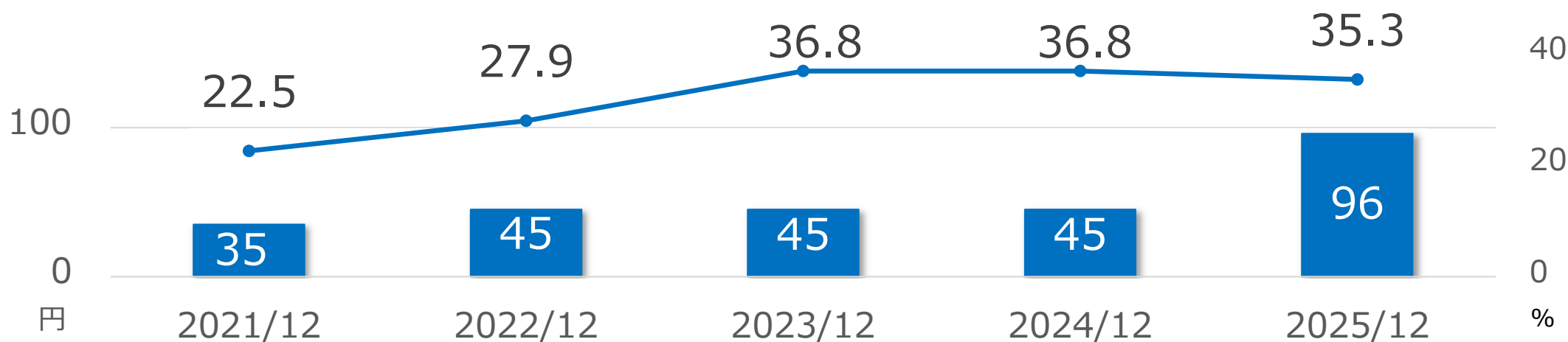
地域セグメント別売上高と比率



※比率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません

株主還元-配当方針を変更

■ 配当金推移



配当方針変更を発表（2025年11月11日）

新方針：連結配当性向35%以上かつ連結株主資本配当率（DOE）4.0%以上

■ 自己株式取得の状況

- 2025年 7月 500,000株
取得した500,000株は消却
- 2023年 6月 286,000株
- 2018年12月 200,000株
- 2017年 3月 200,000株
- 2016年 3月 140,000株
- 2015年11月 500,000株
- 2009年 2月 300,000株

株主優待 ー 制度を一部変更

保有株式数	基準日	継続保有期間	優待内容
100株以上 500株未満	12月末	1年以上3年未満	QUOカード 1,000円分
		3年以上	QUOカード 2,000円分
500株以上	12月末	1年以上3年未満	QUOカード 2,000円分
		3年以上	QUOカード 3,000円分

- (1) 毎年12月末日を基準日とし、当社株主名簿に記載された100株（1単元）以上保有の株主様のうち、継続して1年以上保有する方といたします。
- (2) 継続保有期間が「1年以上3年未満」とは、基準日である12月末および6月末時点の株主名簿において、同一の株主番号で3回以上連続して100株以上の保有が記載または記録されていることをいいます。
- (3) 保有期間が「3年以上」とは、基準日である12月末および6月末時点の株主名簿において同一の株主番号で7回以上連続して100株（1単元）以上の保有が記載または記録されている場合をいいます。
- (4) 株主優待の対象となる「保有株式数」とは、(2)および(3)の保有期間において、基準日を含めた直近3回または7回の株主名簿に記載または記録された保有株式のうち、最も少ない株式数を指します。

※制度変更の適用時期

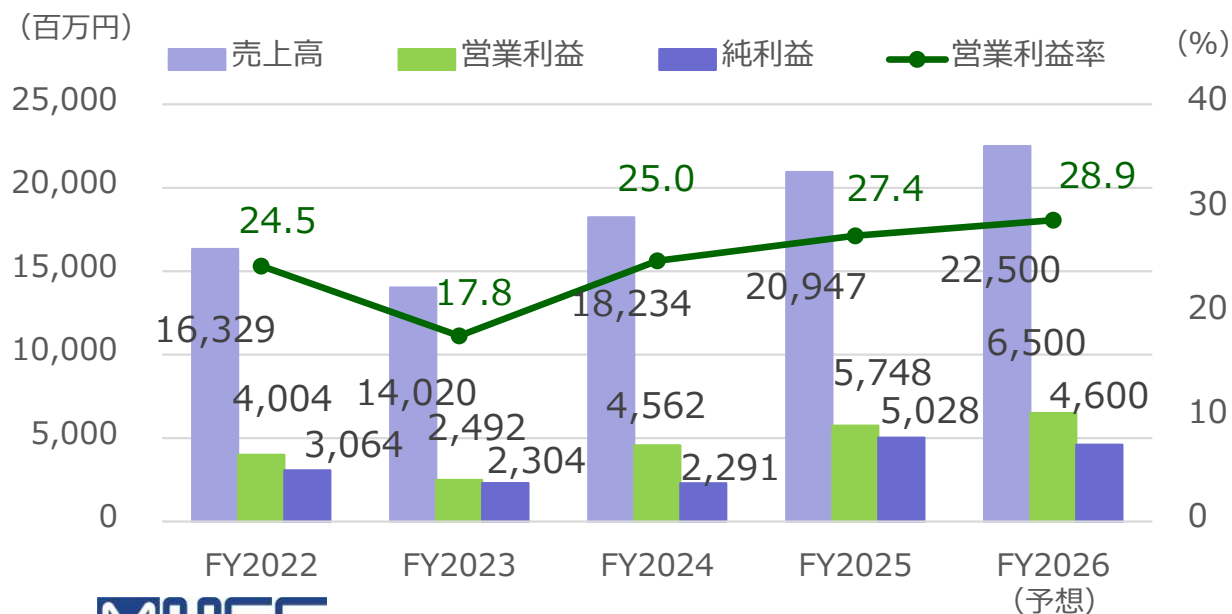
2025年12月末日を基準日とする当社株主名簿に記載または記録された株主様より適用いたします
 なお、経過措置として2025年12月末日基準の株主優待に限り、1年以上の継続保有条件はありません

本日の内容

- メック株式会社について
- 2025年12月期業績について
- **2026年12月期業績予想について**
- 中期経営計画Phase2について

2026年12月期 連結業績予想

	FY2025		FY2026					
	百万円	利益率	1H			Full-year		
			百万円	利益率	増減率	百万円	利益率	増減率
売上高	20,947	-	10,800	-	15.1%	22,500	-	7.4%
営業利益	5,748	27.4%	3,000	27.8%	22.9%	6,500	28.9%	13.1%
経常利益	6,051	28.9%	3,025	28.0%	21.3%	6,550	29.1%	8.2%
純利益	5,028	24.0%	2,000	18.5%	5.6%	4,600	20.4%	△8.5%
1株当たり純利益(円)	272.14	-	109.53	-	-	251.91	-	-



為替レート

	FY2025 (実績)	FY2026 (想定)
N T D	4.81	4.95
R M B	20.94	21.24
H K D	19.30	19.36
T H B	4.57	4.67
E U R	169.14	175.76
U S D	150.40	151.02

北九州工場（仮称）

2026年12月稼働に向けスケジュールどおり進捗しています。



完成イメージ



現在の外観(2026年1月現在)

所在地：福岡県北九州市若松区向洋町10番
敷地面積：29,889m²

本日の内容

- メック株式会社について
- 2025年12月期業績について
- 2026年12月期業績予想について
- **中期経営計画Phase2について**

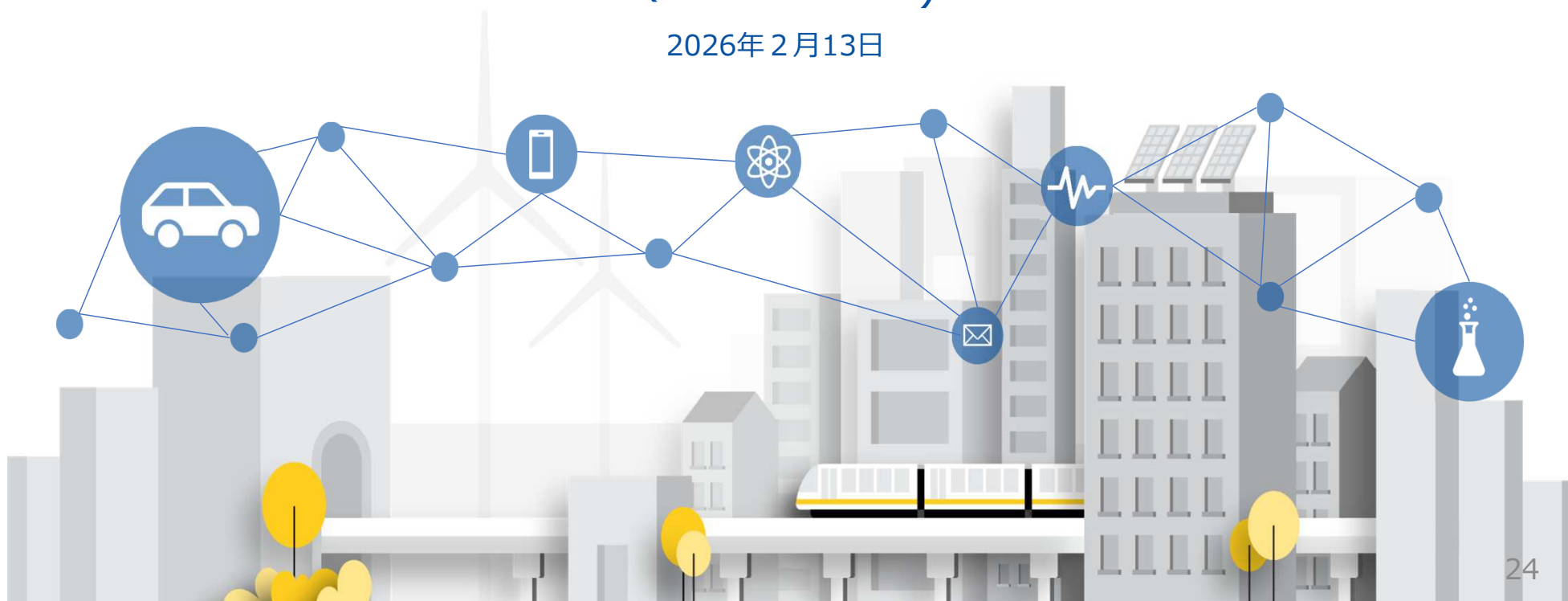
2030年ビジョン

Phase 2 1年目の進捗と今後の取り組み

中期経営計画

(2025-2027)

2026年2月13日



サマリー

- 生成AI関連の需要拡大など好調な市場環境を背景に
「2030年ビジョンPhase 2」1年目の業績は当初想定を上回って推移
- 市場環境と高付加価値製品の需要動向を踏まえ、
 Phase2最終年度である**2027年12月期の目標を修正**
 - 売上高 250億円 ⇒ 250億円
 - コア事業 235億円 ⇒ 245億円
 - 応用展開 15億円 ⇒ 5億円
 - 営業利益率 20%以上 ⇒ 26~30%
 - ROE 10%以上 ⇒ 13~16%
- さらなる株主還元の強化を図るため、Phase 2における**配当方針を**
「連結配当性向35%以上かつ
連結株主資本配当率（DOE）4.0%以上」に変更

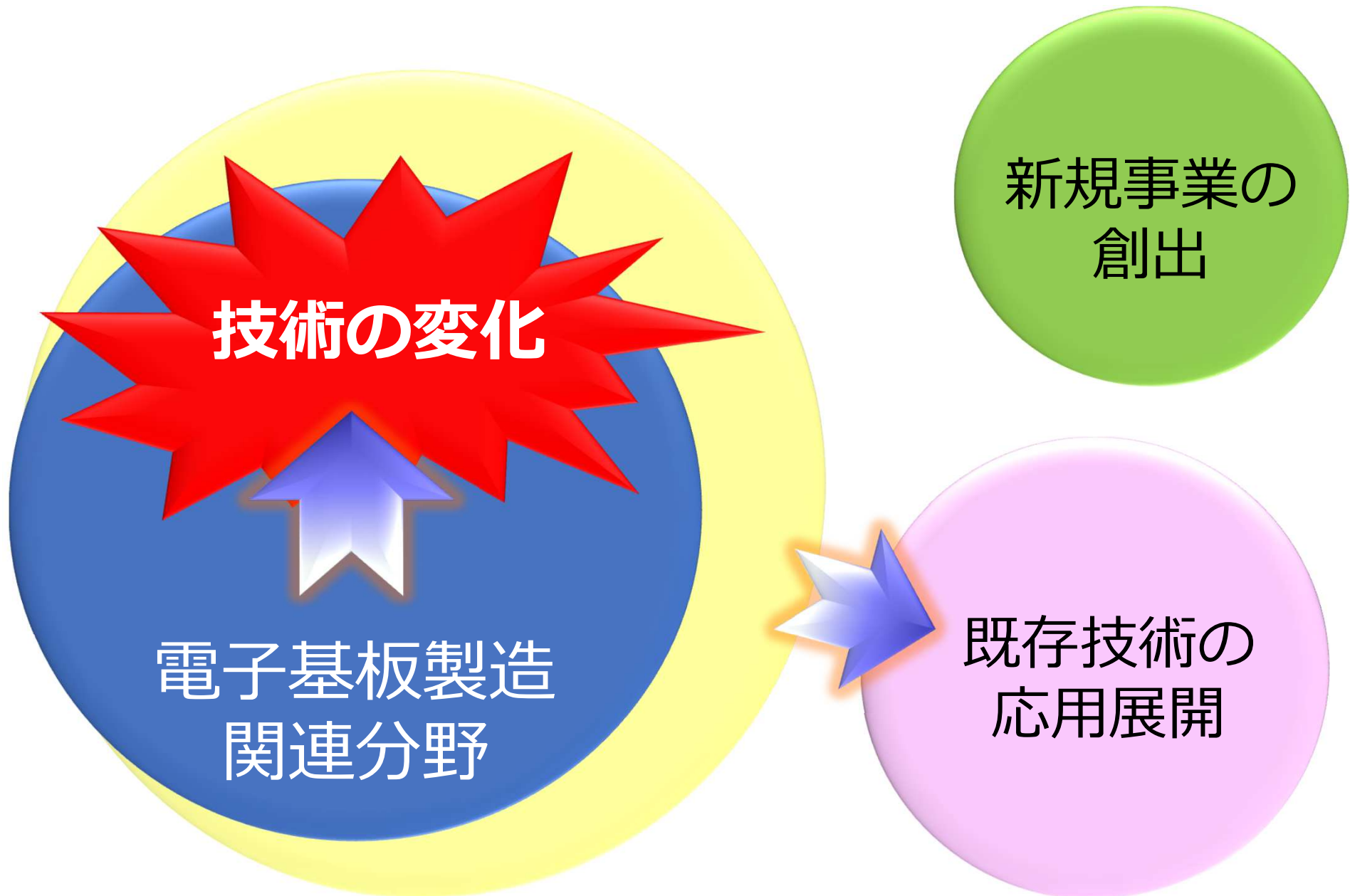
なお、本更新は戦略方針の変更を伴うものではなく、
 既存の中期経営計画の枠組みの中で、数値目標の見直しを行うものです。

定量目標と実績

当社グループが属する市場環境と当社高付加価値製品の需要動向を踏まえ、収益性および資本効率に関する経営目標を明確化します。

	2025年12月期 実績	2027年12月期 当初目標	2027年12月期 修正目標
売上高	209億円	250億円 コア事業 235億円 応用展開 15億円	250億円 コア事業 245億円 応用展開 5億円
営業 利益率	27.4%	20%以上	26~30%
ROE	17.5%	10%以上	13~16%

事業領域の拡大を目指して



ご清聴ありがとうございました



このプレゼンテーション資料には、2026年3月28日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性のあることをご承知ください。



<https://www.mec-co.com/>



Appendix

拠点



1992年設立

● 🏠 **メックヨーロッパ**
【ベルギー】



2001年設立

● 🏠 **メック蘇州**



2002年設立

● 🏠 **メック珠海**



2017年設立

● 🏠 **メックタイ**



1990年設立

● 🏠 **メック台湾**

● 海外子会社

🏠 工場



● 🏠 **本社**
尼崎事業所
(研究所・工場併設)
兵庫県尼崎市
2017年～



● 🏠 **本社**
東初島事業所
(研究所併設)
兵庫県尼崎市
2020年～



● **東京営業所**
東京都立川市
1974年～

● 🏠 **長岡工場**
新潟県長岡市
1993年～

北九州工場 (仮称)
2026年稼働予定
福岡県北九州市若松区

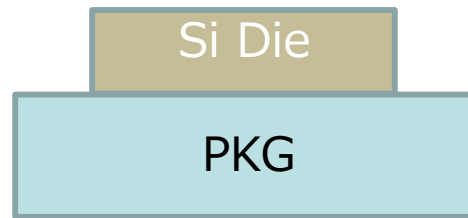


主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。主に半導体パッケージ基板向けの密着向上剤で、高密度電子基板にも使用される。	生成AI関連、5G/6G関連・データセンター等の通信インフラ、パソコン・スマートフォン・タブレットPC等の高機能デバイス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。多層基板向けの密着向上剤で、半導体パッケージ基板には使用されない。	クルマ、スマートフォン、衛星通信等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。主にCOF基板向けのエッチング剤で使用されている。	テレビ・パソコンのモニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

PKGの進化

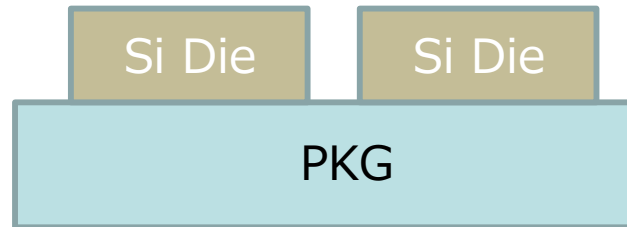
通常のPKG



一つのPKGに
一つの半導体



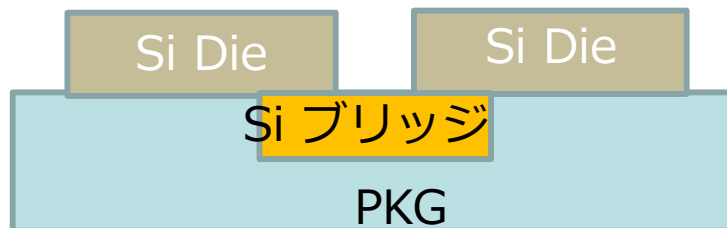
Chiplet



複数の半導体を搭載
PKGを大きく

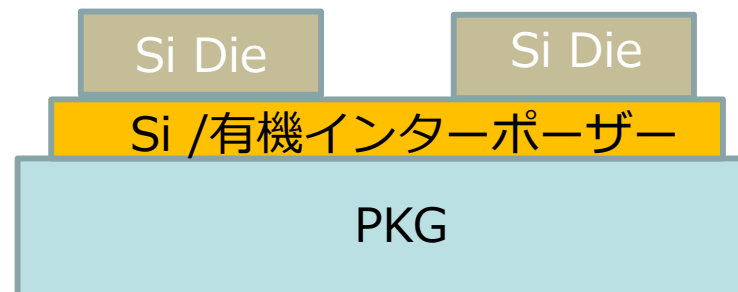
EMIB

(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)



CoWoS

(Chip on Wafer on Substrate)



PKG ⇒ サイズ大型化、層数増加

当社のホームページでは
「プレスリリース」「株主通信」「サステナビリティ報告書」
「コーポレート・ガバナンス報告書」他、
各種情報を掲載しています。ぜひご覧ください



<https://www.mec-co.com/>